

# 2023年3月期 通期決算説明資料

東証スタンダード 証券コード：6614

2023年6月

今を見つめなおし  
人と社会を一步先へ

1. 事業概要・特長
2. 2023年3月期決算の概要
3. 2024年3月期業績予想の概要
4. 成長に向けた取り組み

1. 事業概要・特長
2. 2023年3月期決算の概要
3. 2024年3月期業績予想の概要
4. 成長に向けた取り組み

商号 **株式会社シキノハイテック**  
Shikino High-Tech Co., Ltd.

本店所在地 富山県魚津市吉島829番地

代表者 代表取締役社長 宮本 昭仁

設立年月 1975年1月

資本金 421百万円

発行済株式数 4,424,000株

決算期 3月末

事業内容 電子システム事業・・・半導体検査・装置関連  
マイクロエレクトロニクス事業・・・LSI設計（アナログ・デジタル）、IPコア  
製品開発事業・・・組み込みカメラモジュール、画像システム

従業員数 375名（2023年4月1日時点）

国内拠点 魚津工場、大阪デザインセンター、東京デザインセンター、福岡デザインセンター  
九州事業所、熊本事業所

## 社是

和して拓く

## 社訓

社業を通じ社会に奉仕

企業の永続と繁栄

社員の幸福と人格の向上

## 経営理念

我が社は、お客様の信頼を得る製品とサービスを創り出し、立ち止まらず、高いモラルを有し、発展し続ける企業を目指します。



# 事業拠点展開



電子システム

九州事業所



マイクロエレクトロニクス

福岡デザインセンター



電子システム

熊本事業所



電子システム

第二工場



本社、魚津工場



大阪デザインセンター

マイクロエレクトロニクス  
製品開発



マイクロエレクトロニクス

製品開発

東京デザインセンター



JPEG IP  
W/W mobile20%



JPEG画像圧縮・伸長IP

MIPI IP・ISP IP

- ・ JPEG ・ JPEG XR ・ MIPI CSI-2
- ・ ISP

IPコア (Intellectual Property)  
LSIを構成するための部分的な回路情報のうち特に単一機能をまとめられたもの

車載向けBI装置  
国内トップシェア※

※当社調べ



バーンイン装置・カスタムバーンイン装置

バーンイン

半導体の初期不良を除去する選別方法の一種  
半導体を通常より高温環境下で動作させる試験

IPコア

マイクロエレクトロニクス事業

Digital/Analog LSI  
IP-core



Shikino High-Tech

design, development and  
manufacturing

半導体  
検査装置

電子システム事業

Burn-in solutions  
HD-PLC-module

新商材

高速電力線通信 IoT-PLCモジュール



HD-PLC

カメラ製品

製品開発事業

Camera-module  
System-module

産業用組込カメラ  
国内トップシェア※

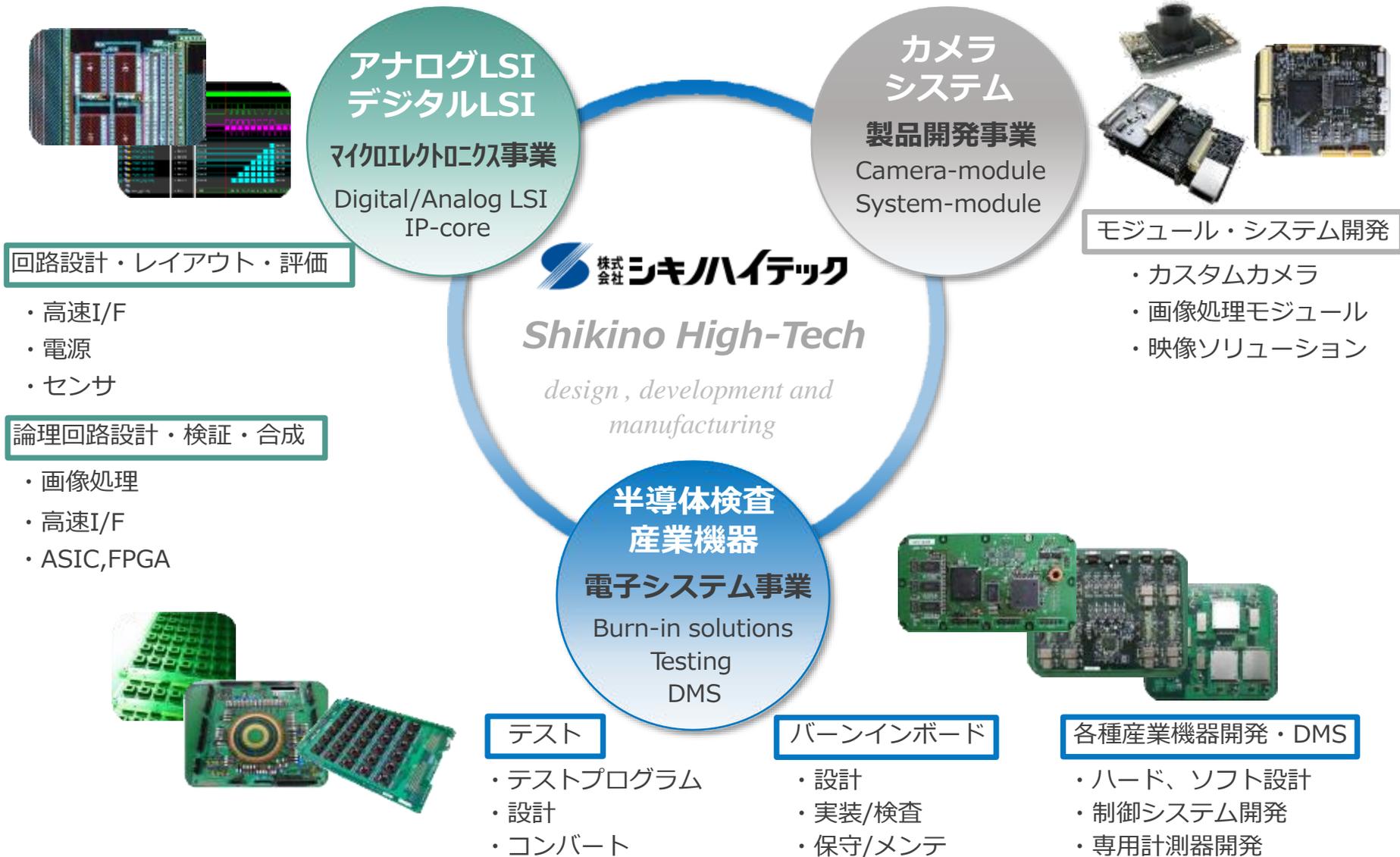
※当社調べ



産業用組込カメラ

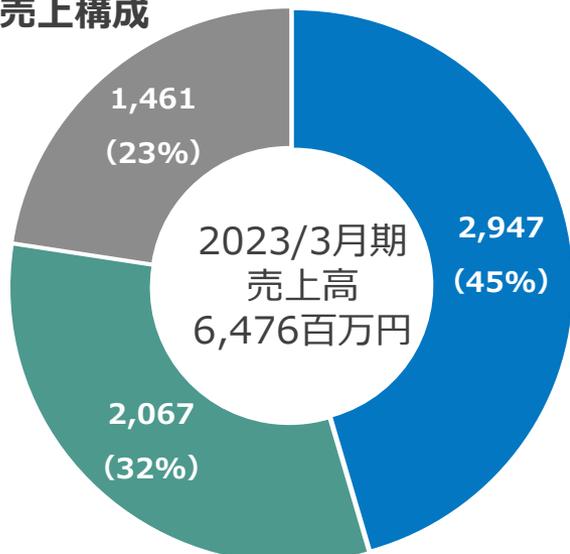
画像処理カメラ

- ・ USB出力
- ・ デジタルYUV出力
- ・ グローバルシャッター
- ・ 文字・コード認識
- ・ ジェスチャー認識
- ・ 印字検査システム



3事業（電子システム事業・マイクロエレクトロニクス事業・製品開発事業）の構成バランスが良く、それぞれが安定した事業展開で推移。  
 上位10社の構成が68%と主要顧客との安定した取引、販売先の分散が図られた強固な顧客基盤を有す。

## 23/3月期 売上構成



## 電子システム事業

### 半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、高速通信機器、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、電子機器の開発・設計・製造

## マイクロエレクトロニクス事業

### LSI設計（アナログ・デジタル）、IPコア

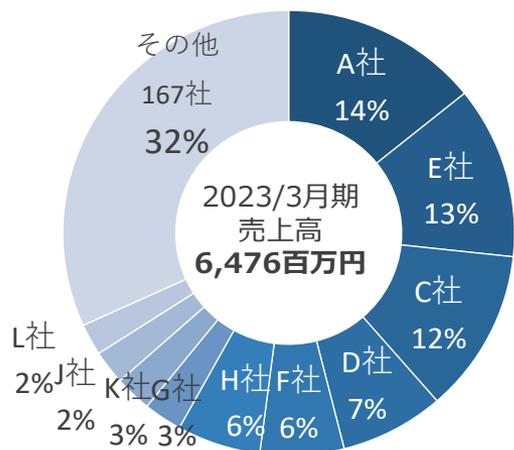
電源IC設計、高速I/F設計、イメージセンサ設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計、技術者派遣、JPEG、MIPI、ISP

## 製品開発事業

### 組み込みカメラモジュール・画像システム

画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール

## 23/3月期 取引先別売上高



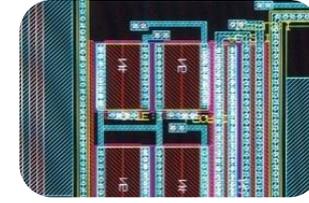
# 当社の主力分野と強み

高成長が期待できる分野に注力、事業環境上のリスク分散が効く事業ポートフォリオ。  
3事業各々で強みを保有、技術・事業連携で事業間シナジーを創出。

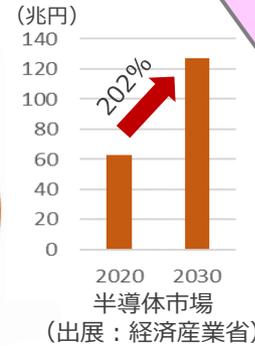
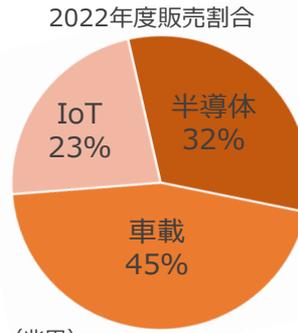
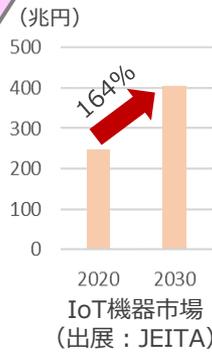
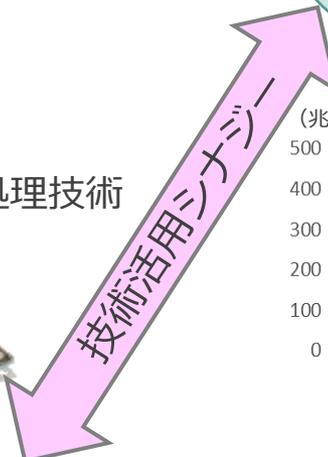


**マイクロエレクトロニクス事業**

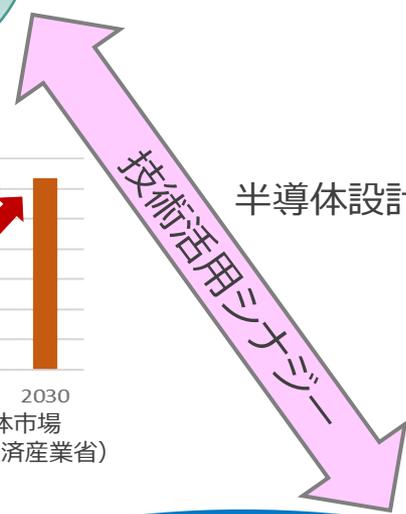
主力分野：成長が期待される半導体  
強み：育成に長時間を要する高度アナログ技術を保有  
デジタル画像処理技術



画像信号処理技術

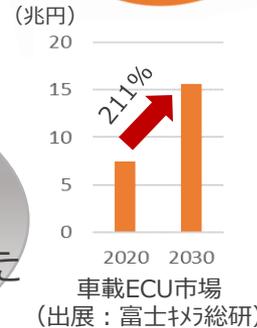


半導体設計・テスト技術



## 製品開発事業

主力分野：AI技術進化で画像処理分野が拡大するセンシング製品  
強み：レンズ～ソフトウェアまで最適化したカメラソリューションを提供



## 電子システム事業

主力分野：車載電子化に伴う半導体に高い信頼性を保証する試験装置  
強み：装置・半導体テストエンジニアを社内に保有

1. 事業概要・特長
2. 2023年3月期決算の概要
3. 2024年3月期業績予想の概要
4. 成長に向けた取り組み

## 2022年度（2023年3月期）は増収増益

- 半導体信頼性試験関連商材、車載機器向け専用計測機および産業機器向けカメラで受注は順調に推移。
  - ・第3～第4四半期において、予想以上の増収。
  - ・利益面でも、高付加価値製品の取り組み、コスト削減の効果及び価格転嫁の理解を得て計画以上の増益。
- 一方、世界的な半導体部材の調達難、調達期間の長期化、価格の高騰に対する対応が必要な年度であった。

(単位：百万円、%)

科目	2022/3月期 実績		2023/3月期 実績		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
売上高	5,359	100	<b>6,476</b>	<b>100</b>	1,117	20.8
営業利益	396	7.4	<b>657</b>	<b>10.1</b>	260	65.7
経常利益	416	7.8	<b>668</b>	<b>10.3</b>	251	60.4
当期純利益	327	6.1	<b>477</b>	<b>7.4</b>	149	45.7

# 決算状況① 前年同期比

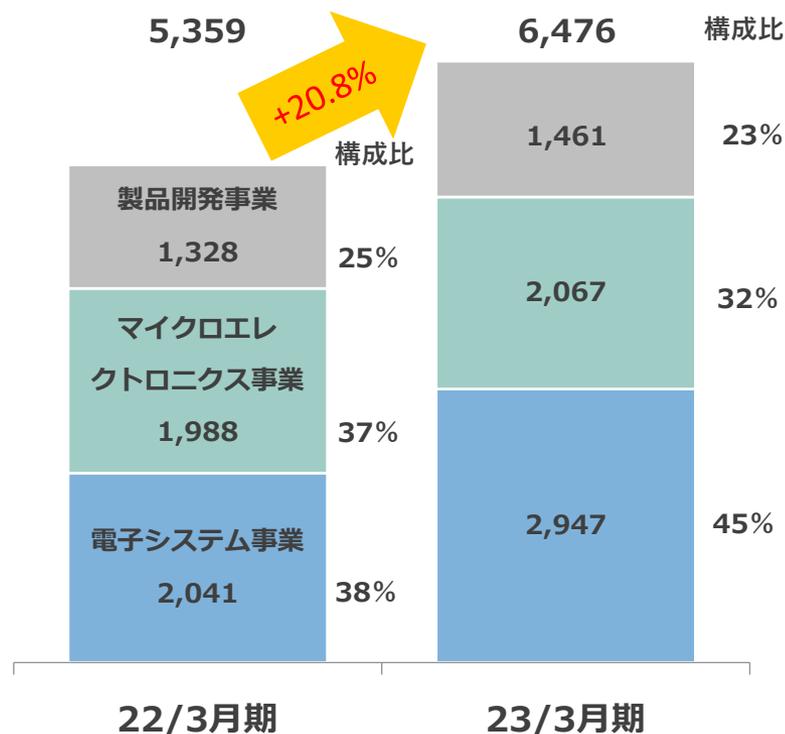
車載用半導体の生産増による後工程商材、新製品用カスタムバーンイン商材の受注が増加し電子システム事業が前期比+44.4%と大幅増収。

マイクロエレクトロニクス事業も旺盛な半導体設計需要に支えられ、堅調に推移。

製品開発事業も国内外におけるインフラ・産業機器市場向けカメラ搭載機器の需要が増加。

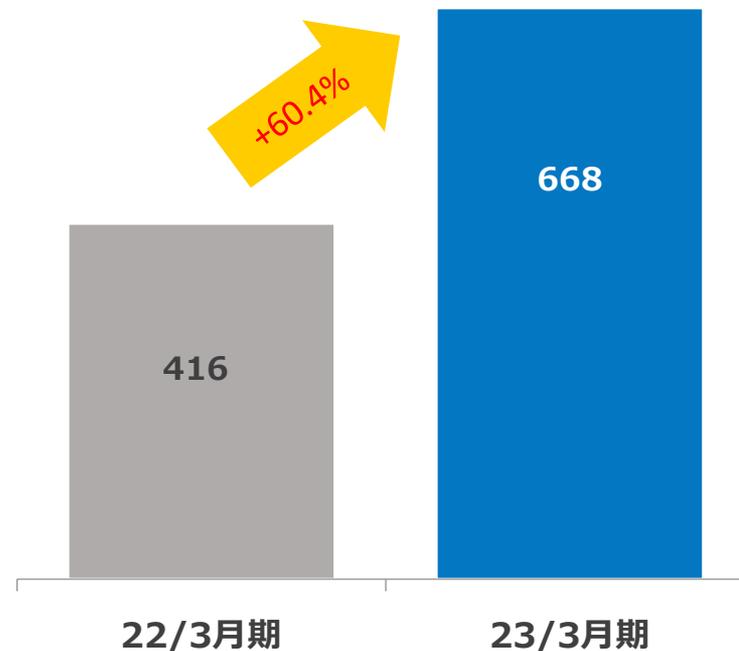
## 【売上高】

(単位：百万円)



## 【経常利益】

(単位：百万円)

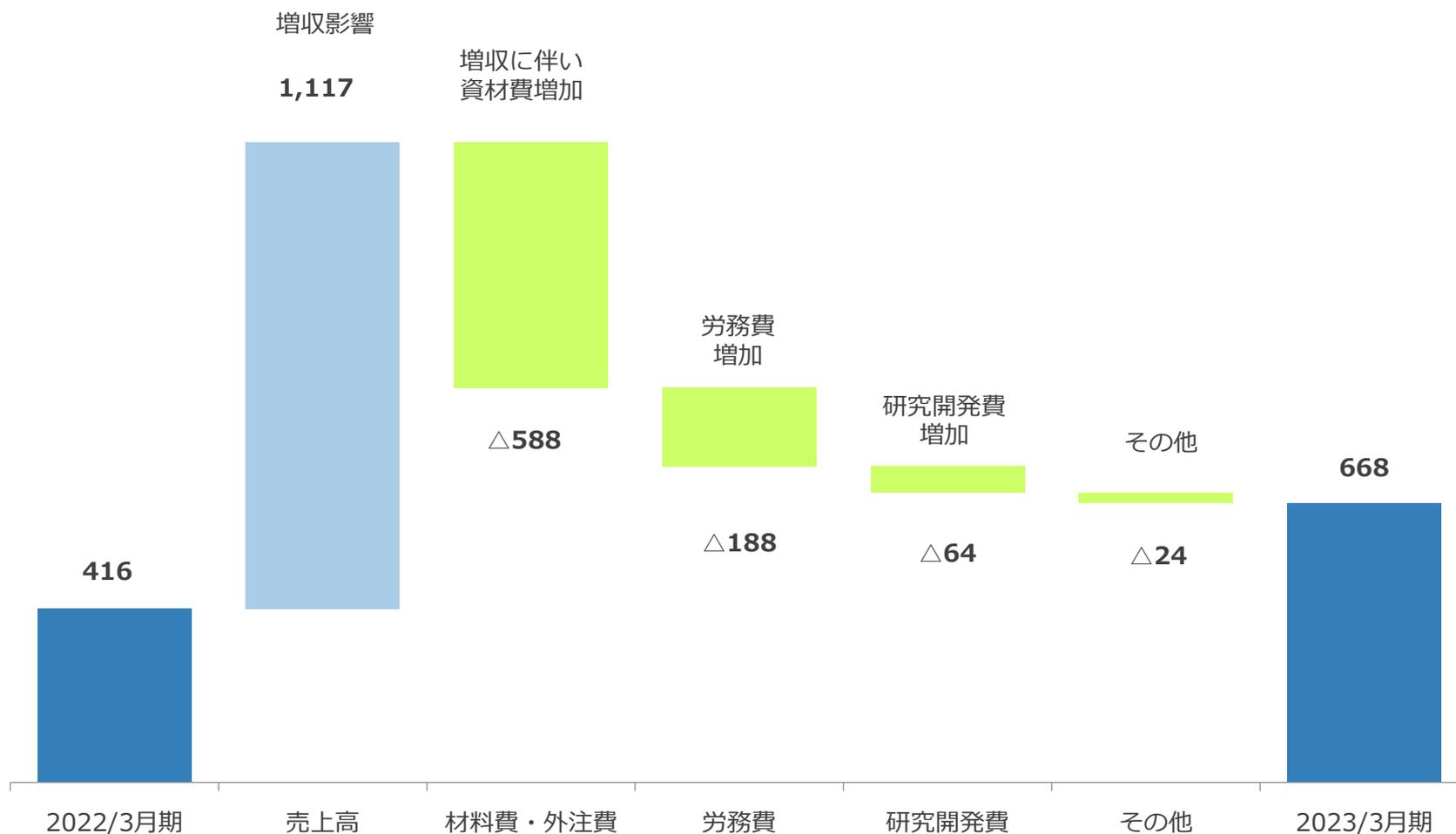


※売上高・経常利益とも前期比で増収増益。

増益要因

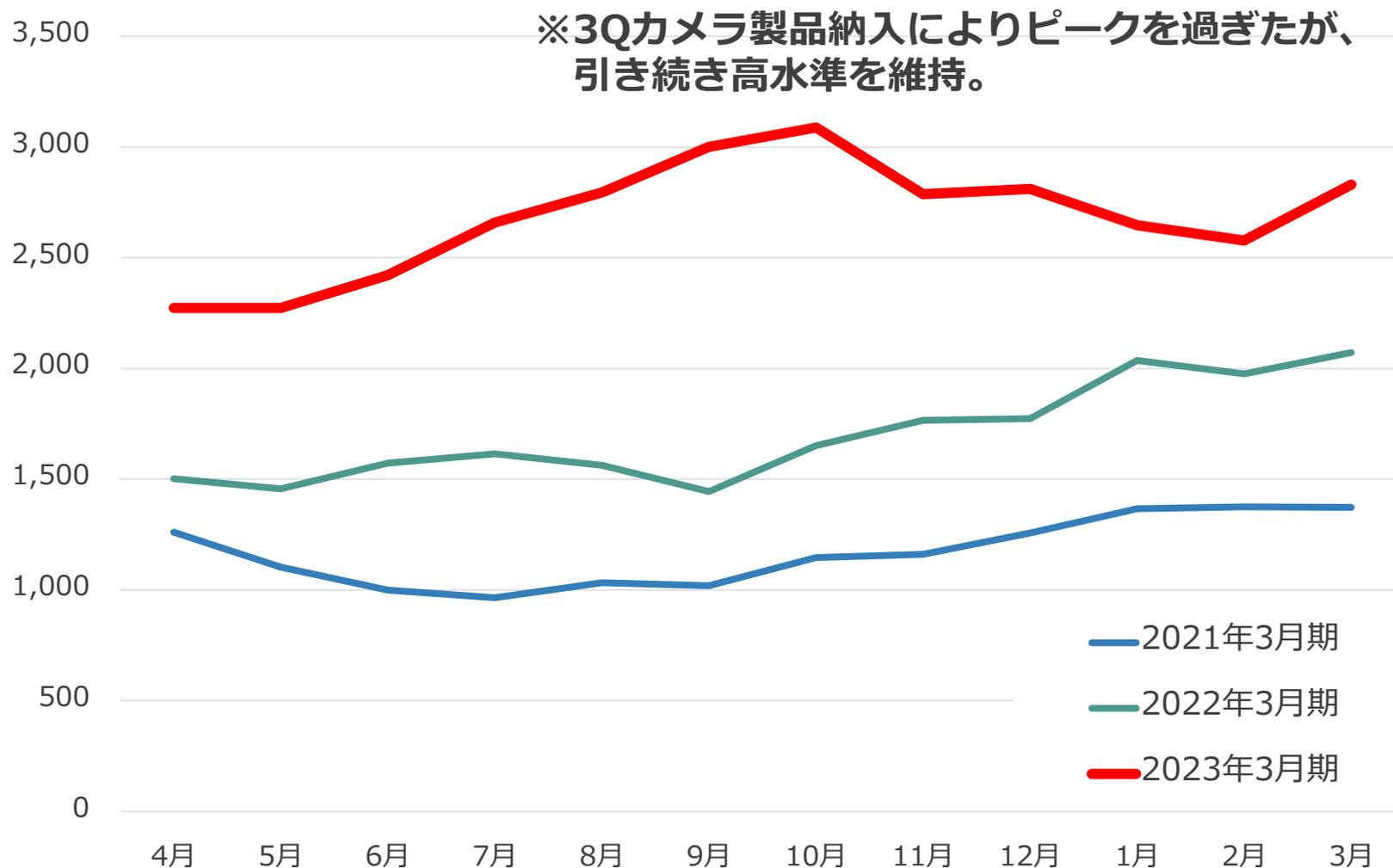
減益要因

(単位：百万円)



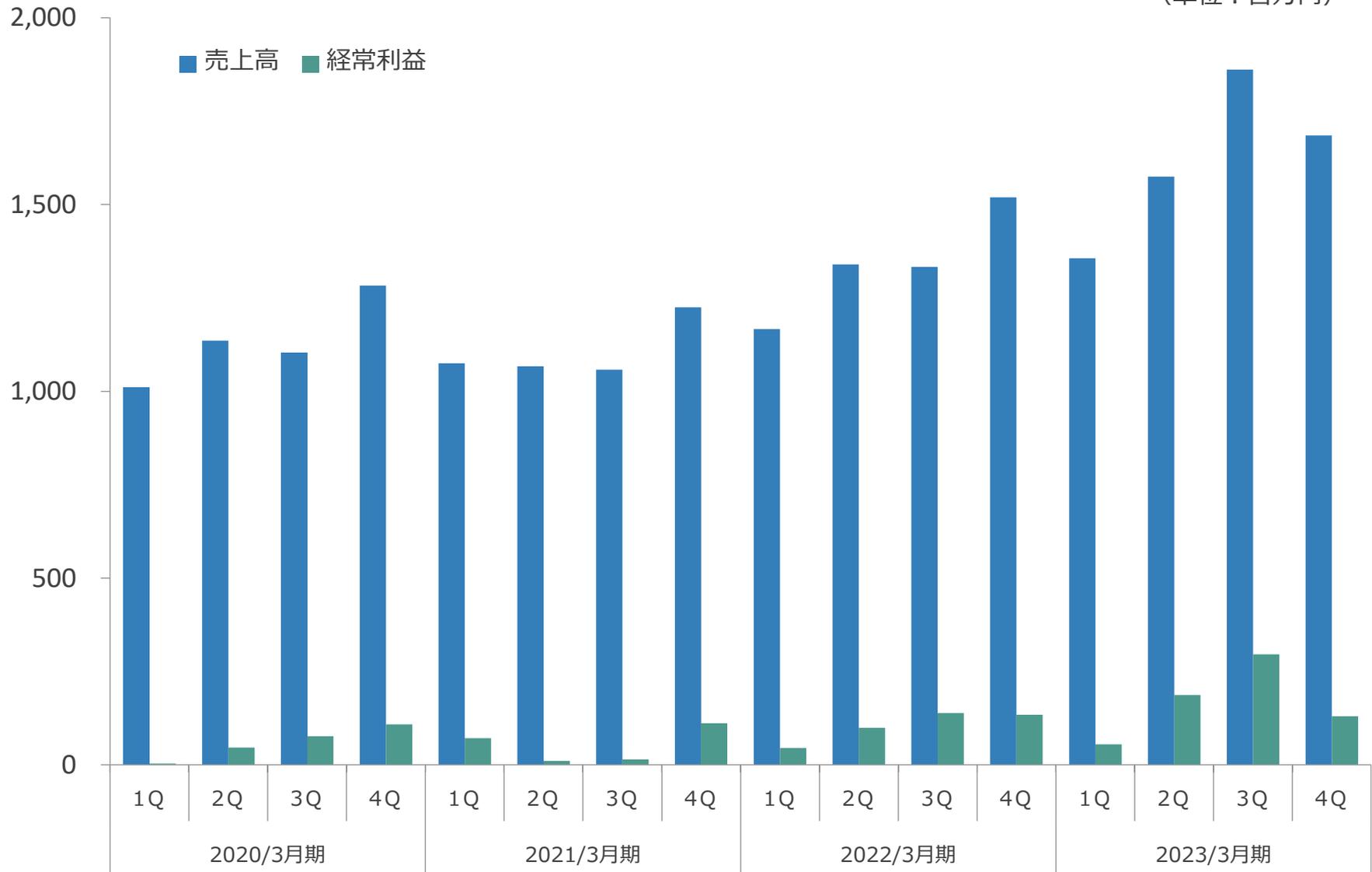
## 【受注残高（全社）】

（単位：百万円）



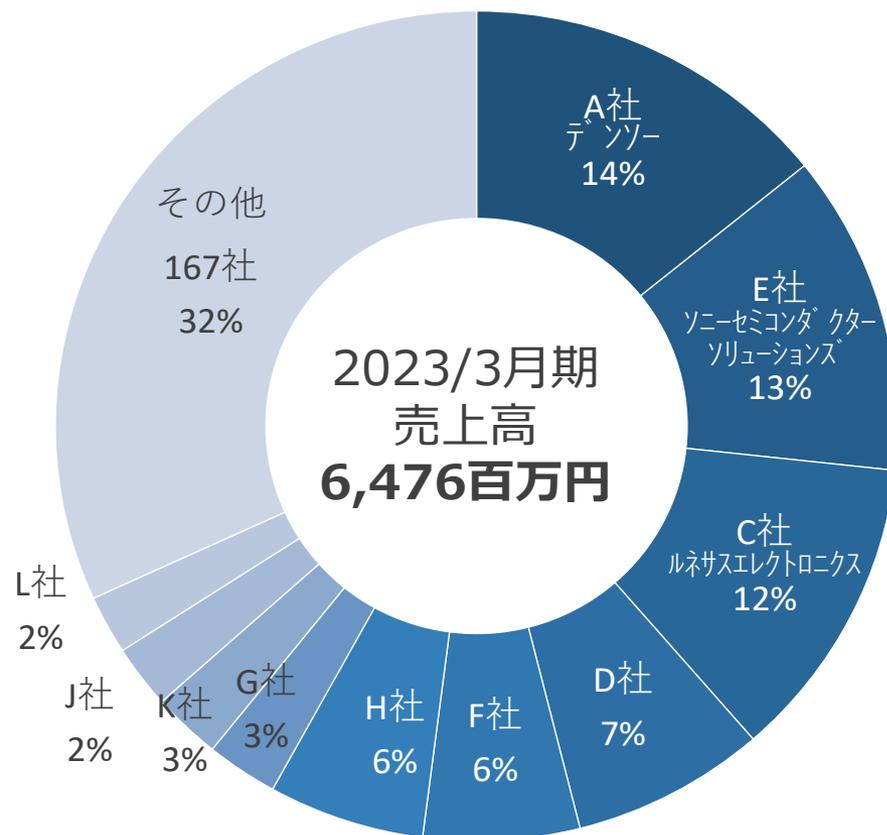
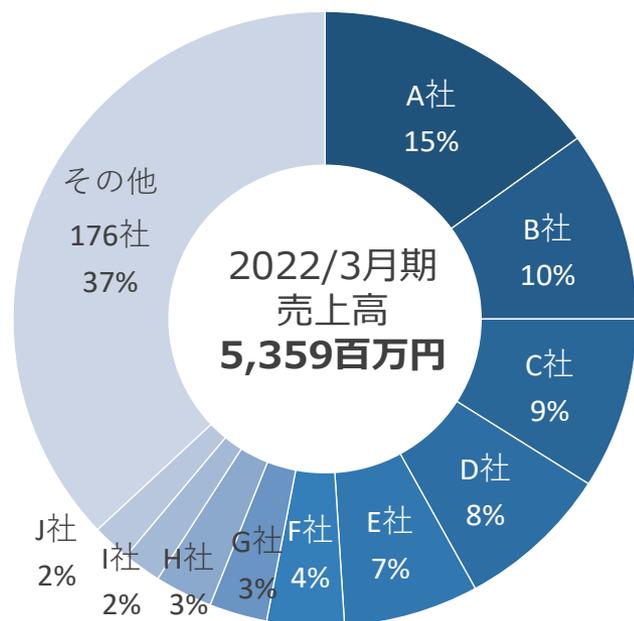
# 四半期業績推移

(単位：百万円)



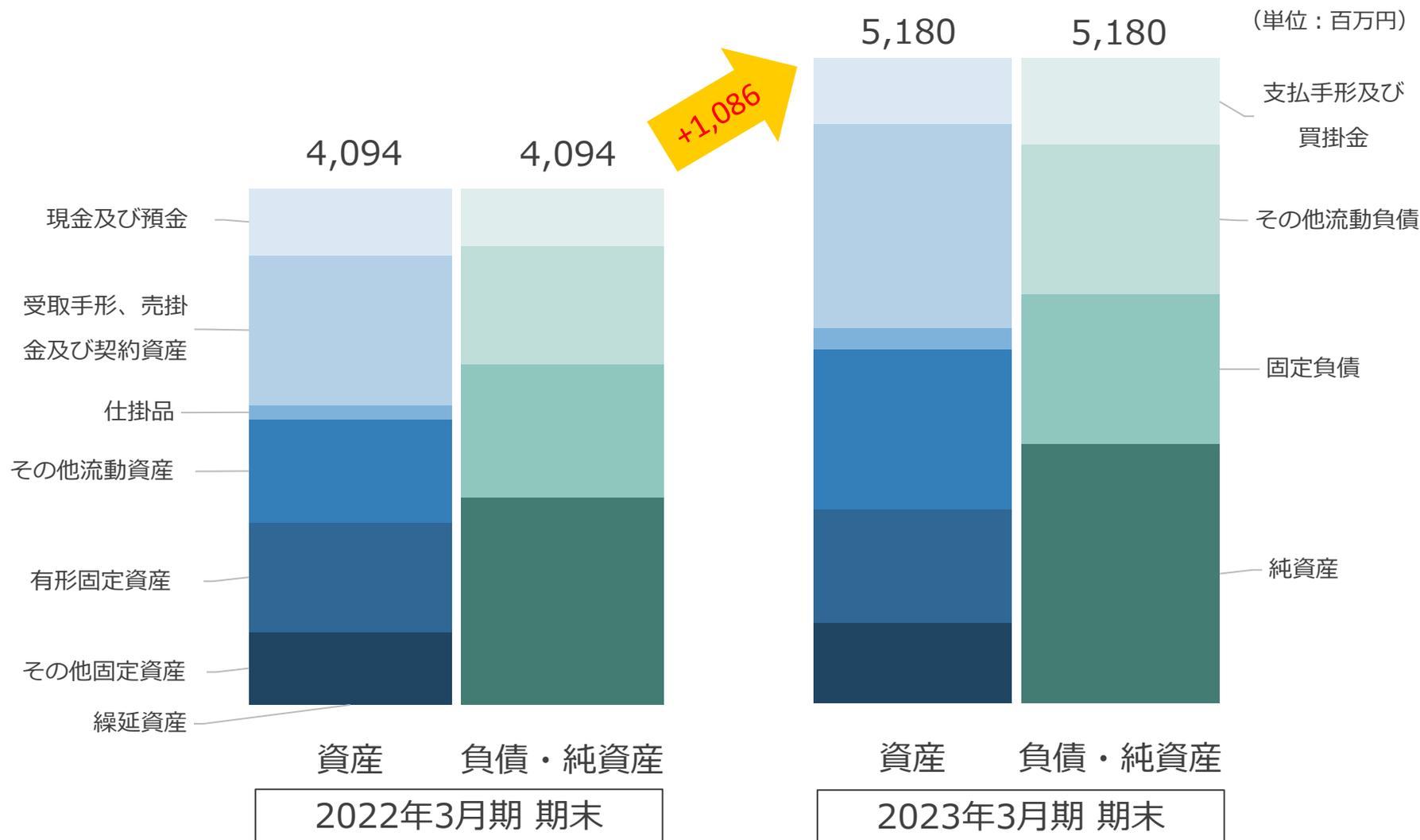
# 取引先別売上高

主要顧客との安定的な取引と販売先の分散が図られた強固な顧客基盤。  
22年度では主要10社構成比率が 63% → 68% に上昇。

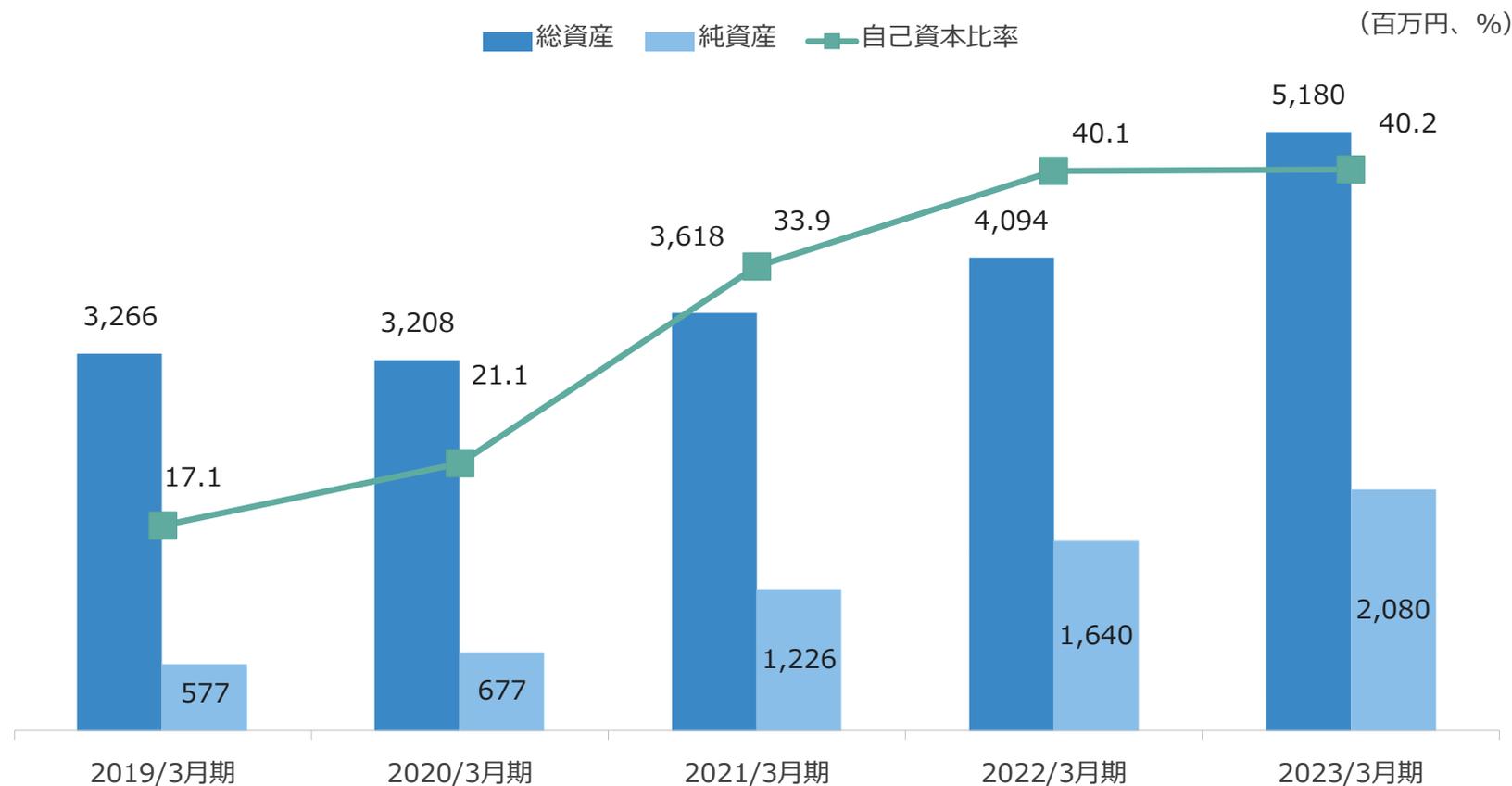


# 貸借対照表

増収要因、部材の先行調達による流動資産が増加。  
 部材の先行調達のための短期借入金が増加など一時的に流動負債が増加。  
 着実な利益計上により、純資産も増加。

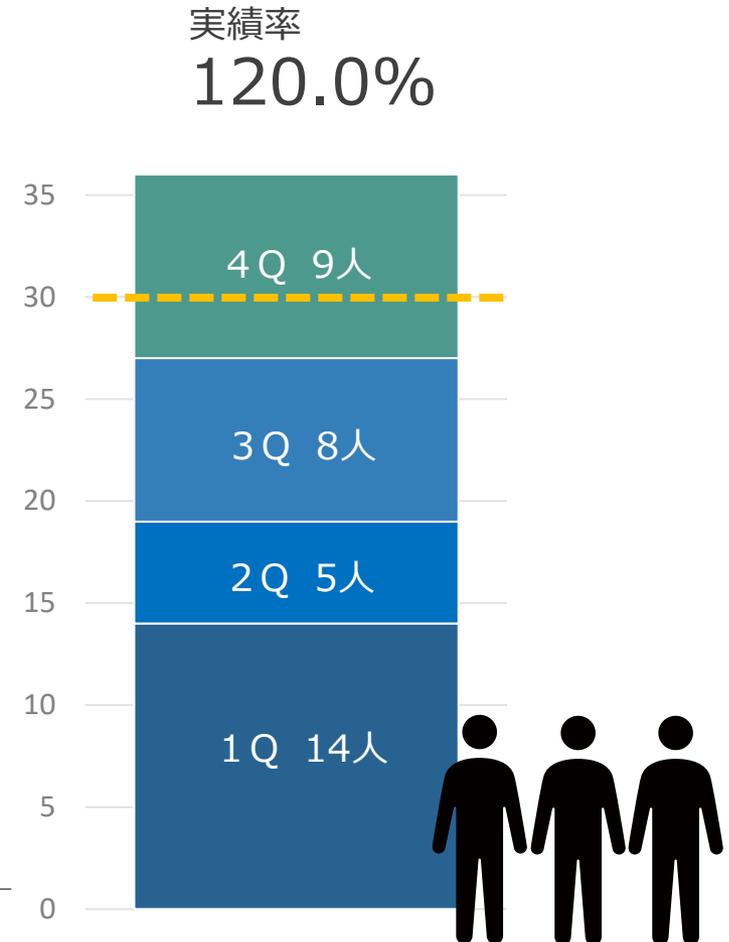


2022/3月期まで自己資本比率は上昇基調、2023/3月期は、利益計上で純資産増加したが増収要因と部材先行調達等に伴う流動資産増などにより、自己資本比率は横ばい。  
(前年比では+0.1ポイント)



- 好調な受注環境と成長に対応するため、継続的に人員増強を図っています。
- 通期で30人（技術：18人）の採用計画に対し、36人の採用となりました。

人員  
通期採用計画：30人



# 今期計画に対する実績【研究開発】

研究開発の投下「工数」は、一部テーマの見直し・入替え実施により進捗率は若干未達。研究開発費での進捗に対する差分は、主に開発単価の予実差異によるものとなります。

## 主要開発テーマ

### 電子システム事業

- ・半導体検査装置・カスタム検査装置  
次世代IoT-PLC通信モジュール

### マイクロエレクトロニクス事業

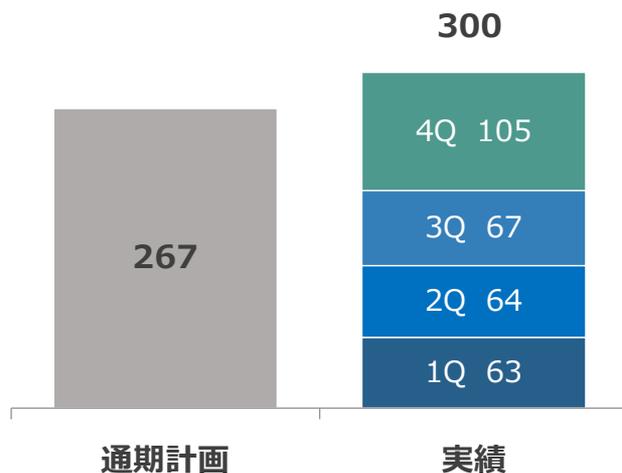
- ・JPEG IPコア・画像処理ISP IPコア

### 製品開発事業

- ・高画素/NWカメラ・3Dカメラ・介護向けシステム

### 【研究開発費】

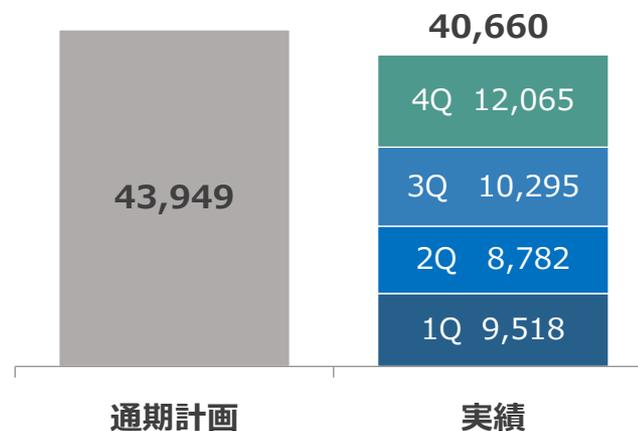
(単位：百万円)



実績率 112.2%

### 【研究開発工数】

(単位：H)

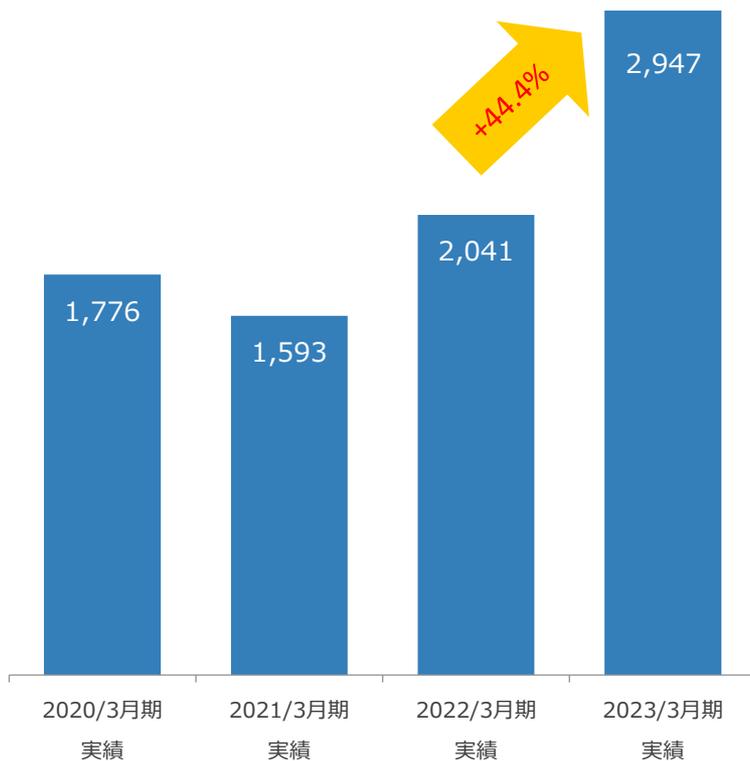


実績率 92.5%

車載用半導体生産向け後工程商材の受注増、新製品用カスタムバーンイン商材の受注と車載製品用専用計測機器の受注も堅調に推移。

【売上高】

(単位：百万円)



## 22年度 トピックス

- 車載製品向けを中心に主要商材の受注好調継続



バーンインボード

前年比：202%



半導体検査装置販売・リース

前年比：111%



車載製品用専用計測機器関連

前年比：133%

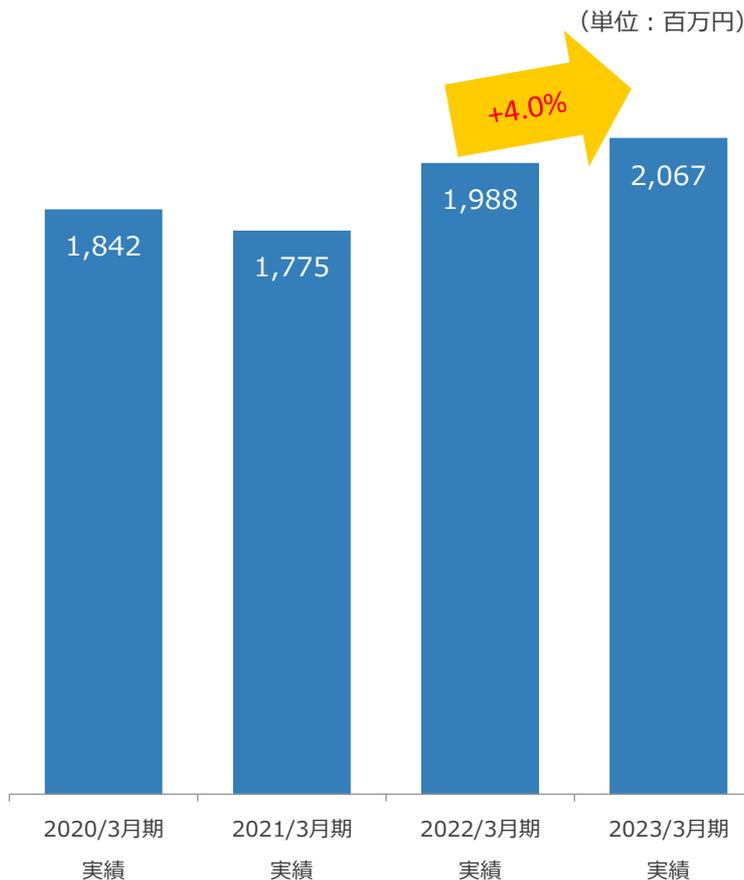
- IoT PLC通信機器の所属組織PLC-J内の運営委員会に当社参画。

PLC-J



旺盛な半導体設計需要に支えられ、アナログはセンサーを主軸にパワー半導体、メモリ分野、デジタルは画像処理半導体の設計需要が継続、IPはJPEG-IPと画像処理IPが堅調に推移。

## 【売上高】



## 22年度 トピックス

### ➤ アナログ半導体設計受託

組み込みメモリ関連  
アナログ設計受託  
前年比：154%



パワー半導体関連  
アナログ設計受託  
前年比：168%

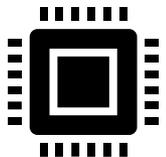


### ➤ デジタル半導体設計受託

DSC向け画像処理関連  
デジタル設計受託  
前年比：113%



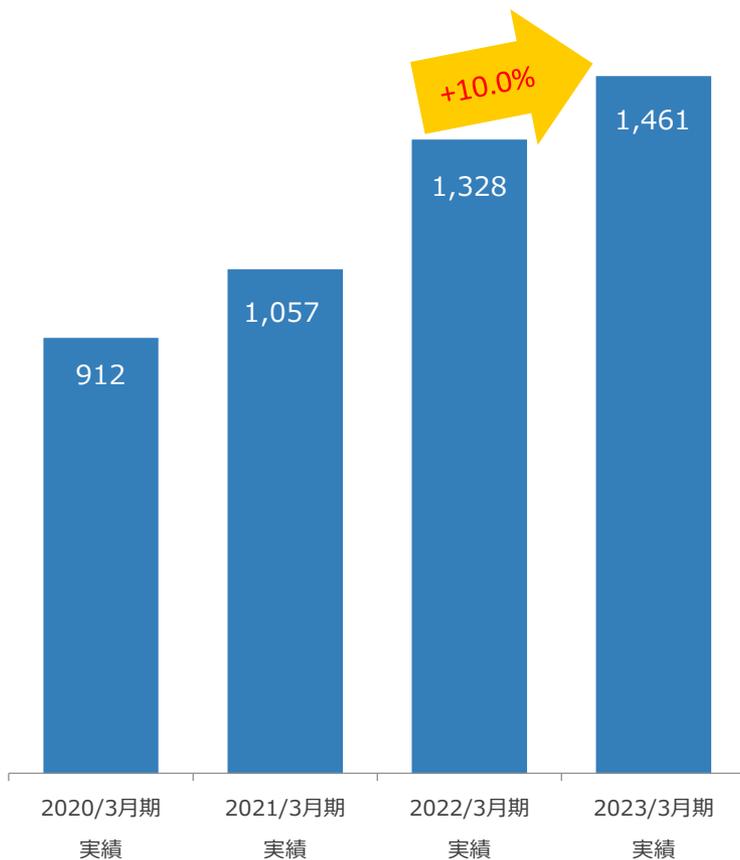
JPEG-IP、ISP-IP  
前年比：118%



国内DX推進によるマイナンバー応用機器、セルフレジ、海外ATMなど産業・インフラ用途向けカメラ搭載機器の堅調な増加により売上・出荷台数とも順調に増加。

【売上高】

(単位：百万円)

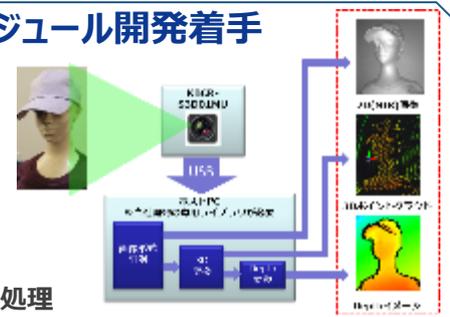


## 22年度 トピックス

### 2D/3Dセンシングカメラモジュール開発着手 【KBCR-S3D01MU】

ステレオやToF方式と比べて

- 移動する対象物の計測が可能
- 複雑な構造物の測定が可能
- 処理が軽く低レイテンシ、高fps処理



Care Show Japan 出展  
見守りシステム参考出展

2月



KBCR-S07VUE

新製品

12月

国際画像機器展2022出展



KBCR-iC21MG

新製品

10月 主要デバイスマルチ化対応  
30万画素USB出力カメラリリース

9月

エッジ画像処理用 120万画素  
インテリジェントカメラLiteリリース

6月

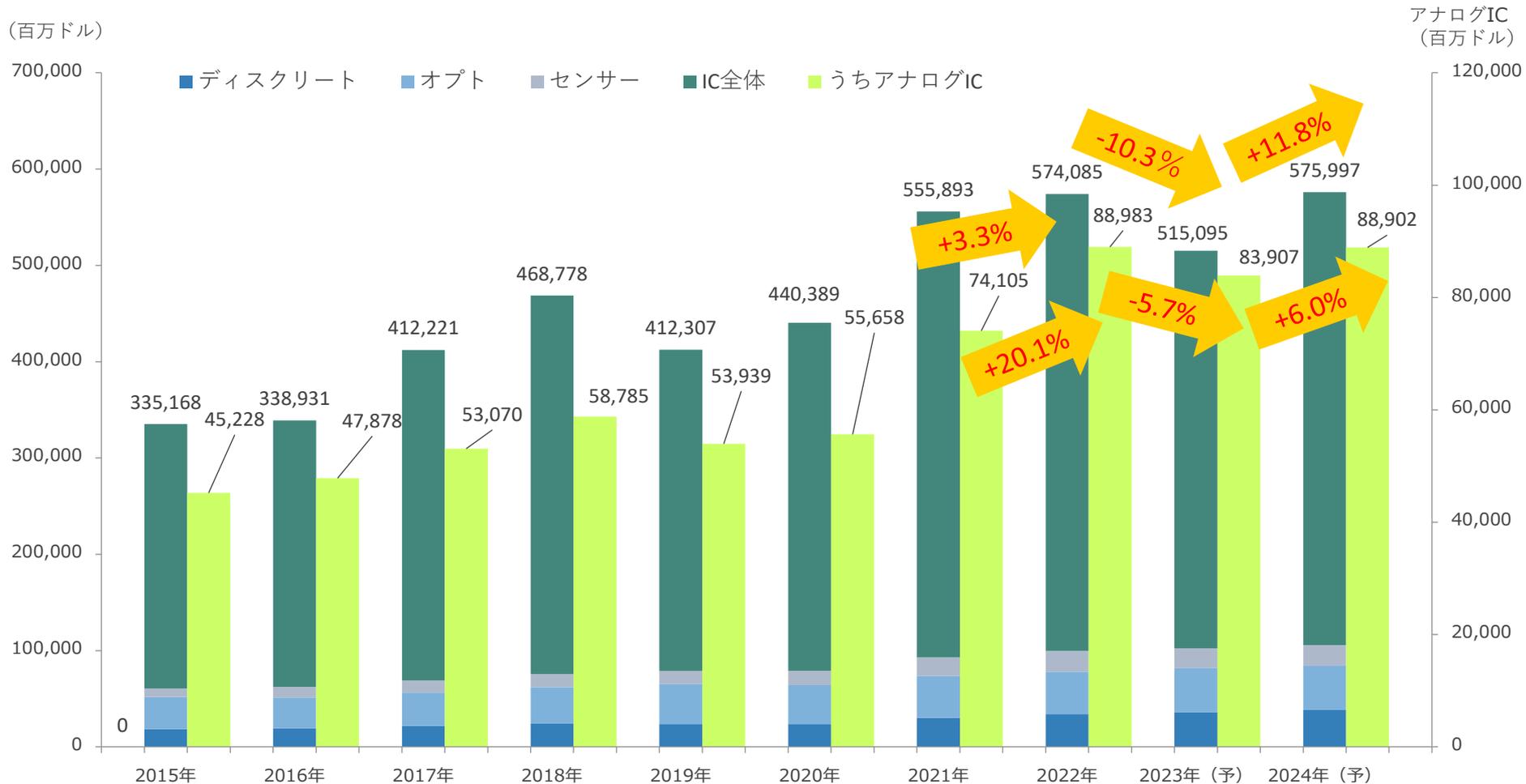
ルネサス RZパートナーエコシステム加入

4月

MagikEye Incとの資本業務提携

1. 事業概要・特長
2. 2023年3月期決算の概要
3. 2024年3月期業績予想の概要
4. 成長に向けた取り組み

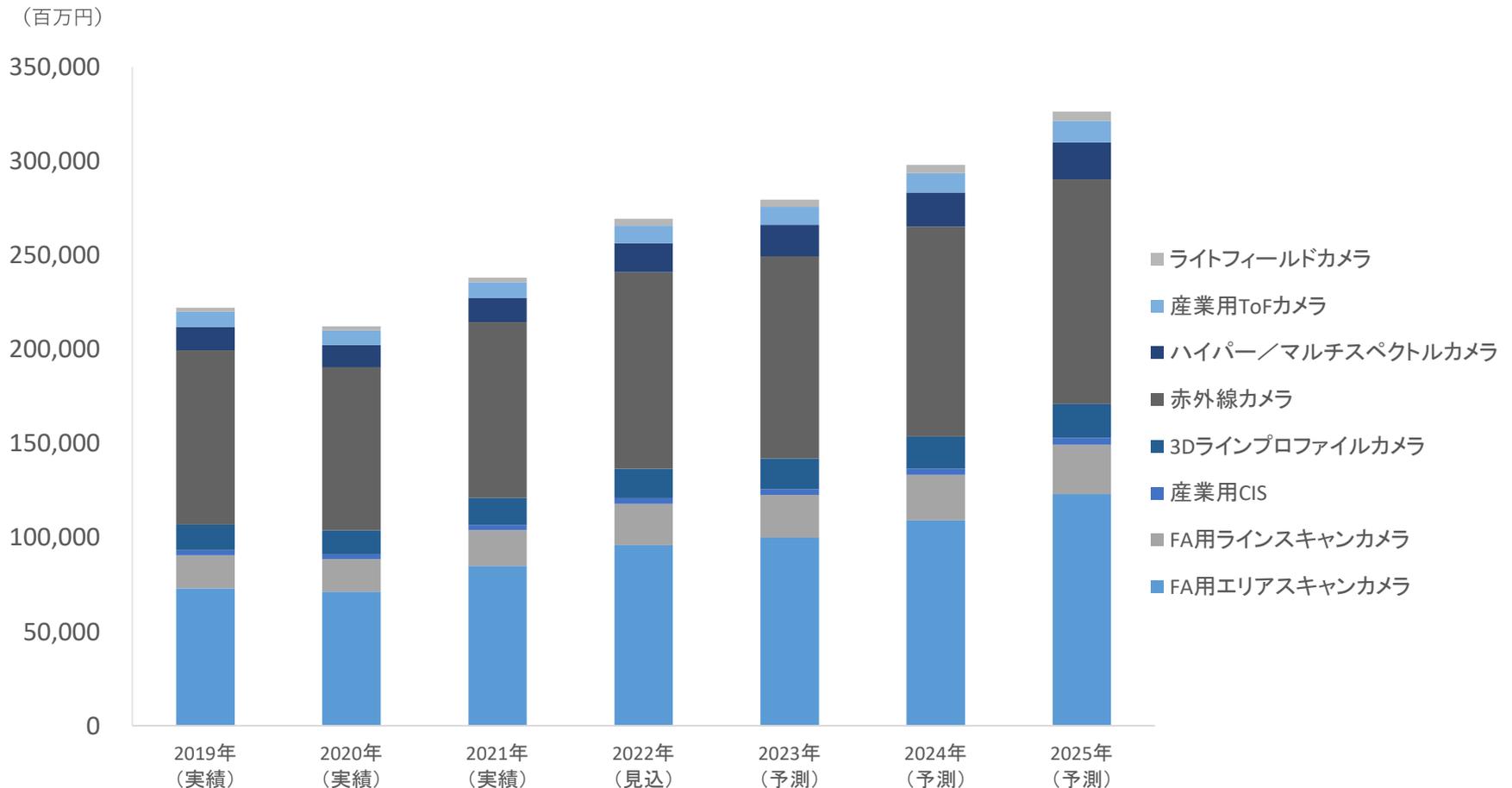
新型コロナ影響での、PC・5G関連・データセンター機器等が半導体をけん引し2022年までは成長、2023年はインフレの影響で個人消費に依存している市場の需要減退し2桁の市場成長率減も2024年にはほぼ2022年並みに回復。



出所：WSTS (WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS：世界半導体市場統計) 2023年春季半導体市場予測より当社作成

# カメラ市場の動向 (W/W)

2020年後半からコロナ影響が回復、半導体関連の部品不足が顕在化しているものの、製造業を中心とした自動化が促進。半導体不足の解消が進むであろう2024年以降市場拡大の加速が予測される。2025年度にかけ毎年+8~10%の成長が見込まれている。



出所：株式会社富士経済「2023画像処理システム市場の現状と将来展望」より当社作成

## ●半導体関連

'23年度の市場は大幅減も'24年度は回復 (WSTS '23/6)

'23年度 ▲10.3%の市場減、'24年度 +11.8%の市場増

- 各国政府補助金拠出で半導体製造設備への投資が'23年度は促進。(Jetro '23/5)
- 車載機器は'22年度半導体不足で製造設備投資は抑えられたが'23年度は2桁成長。(富士経済 '22/12)
- カメラ搭載機器を含むIoT機器は継続し市場成長。'23年度104%成長。(富士経済 '22/12)

### 電子システム事業

- 車載半導体生産能力向上に伴う検査装置/ボードの需要は堅調
- センサー、光、パワーデバイス等新規デバイスに対する検査の導入
- BI検査の設備投資から装置レンタル、検査委託などニーズの多様化

### マイクロエレクトロニクス事業

- パワー半導体の市場はSDGs・車載EV拡大を背景に堅調に拡張
- 当社顧客において国内の画像処理半導体の大規模LSI設計需要は23年度末に向け収束
- 半導体設計人材の争奪戦は継続

### 製品開発事業

- 国のDX推進によるインフラ市場の需要が回復・加速
- センサとしてのカメラ用途が認識/認証・自動化用途で拡大
- 医療検査機器での検査自動化に向けたカメラ用途が拡大

## ●23年度注力製品

カスタム半導体検査装置  
産業用専用計測器  
IoT-PLCモジュール・アダプター

車載関連半導体設計  
センサー・パワー関連半導体設計  
画像関連IP

ATM向けカメラ  
FA機器向けカメラ  
センシングカメラ

# 2024年3月期業績予想

## 2023年度（2024年3月期）は増収減益（減益は積極的な開発先行投資に起因）

- 顧客ニーズを的確に捉え、生産性のより一層の向上と機動力を発揮して取り組みます。
- 3年後の大きな飛躍を見据え、新技術の開発に積極的に先行投資（前期比+205百万円）するため、売上増加率は3.1%となりますが、経常利益増加率は▲16.2%となります。

### 全社

(単位：百万円)

	2023/3月期 通期実績	2024/3月期 通期予想	増減額	増減率
売上高	6,476	6,680	203	3.1%
営業利益	657	560	△97	△14.8%
経常利益	668	560	△108	△16.2%
当期純利益	477	430	△47	△9.9%
研究開発費	300	506	205	68.5%

### セグメント別

(単位：百万円)

	2023/3月期 通期実績	2024/3月期 通期予想	増減額	増減率
売上高	6,476	6,680	203	3.1%
電子システム事業	2,947	2,950	3	0.1%
マイクロエレクトロニクス事業	2,067	2,113	45	2.2%
製品開発事業	1,461	1,617	156	10.6%

# 売上高の推移

全事業セグメント増収。

電子システム事業では車載機器生産増加に伴う産業用専用機器が増加。

マイクロエレクトロニクス事業では車載半導体設計での設計需要の増加。

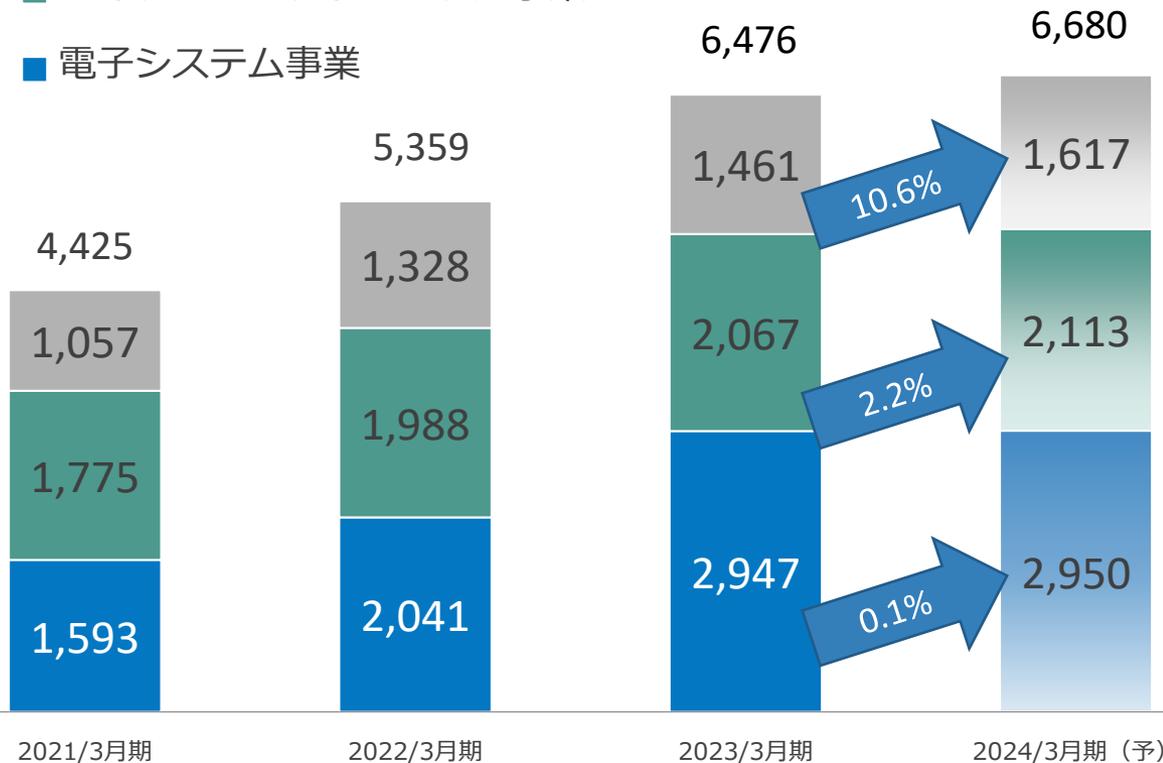
製品開発事業ではATM関連の増加および新製品導入効果により前年比+10%増加を見込む。

■ 製品開発事業

■ マイクロエレクトロニクス事業

■ 電子システム事業

(単位：百万円)



製品開発事業

ATM向けカメラ  
産業機器向けカメラ  
センシングカメラ

マイクロエレクトロニクス事業

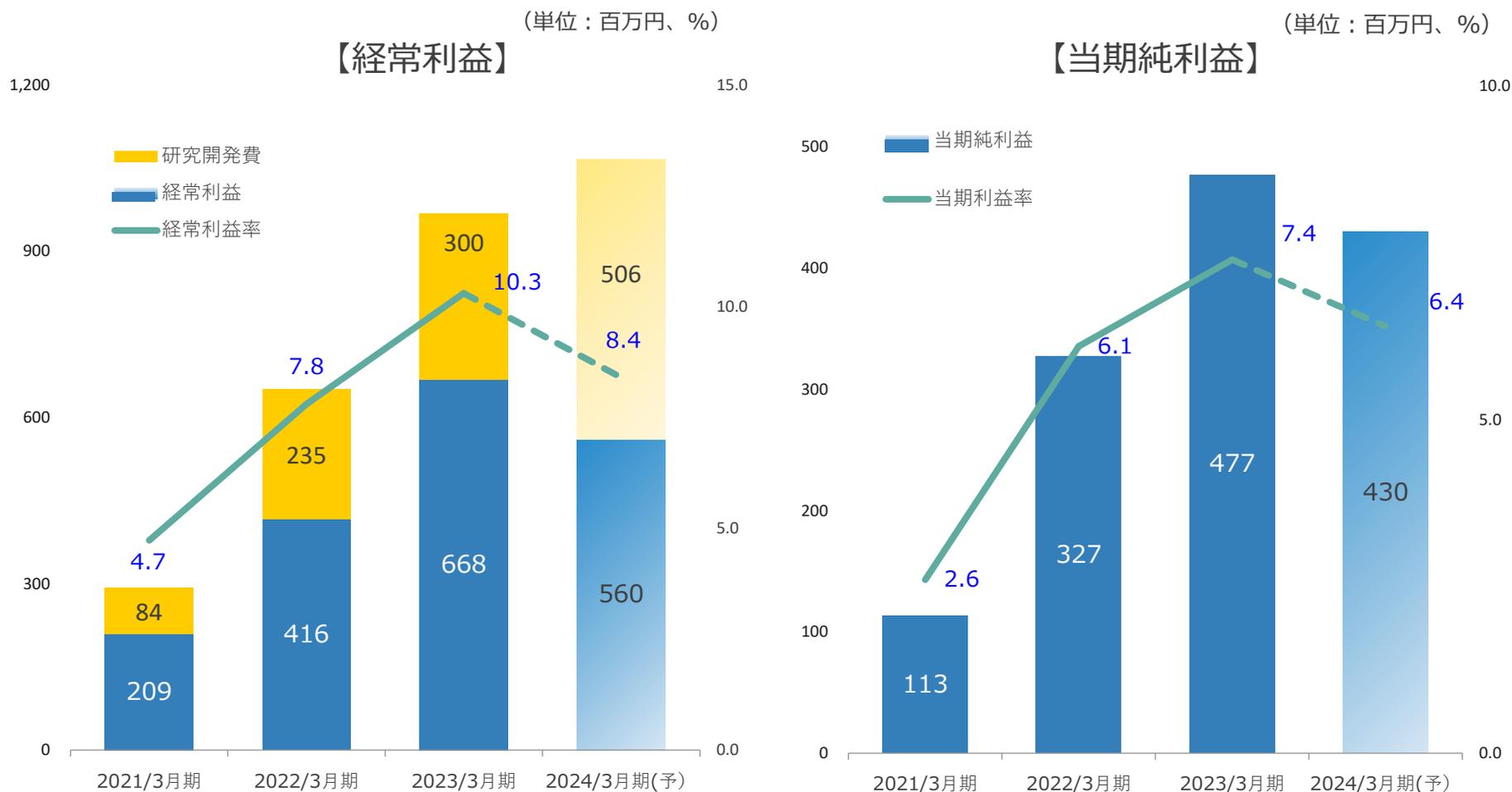
センサー・パワー・車載半導体設計  
静止画像圧縮伸長 JPEG IP

電子システム事業

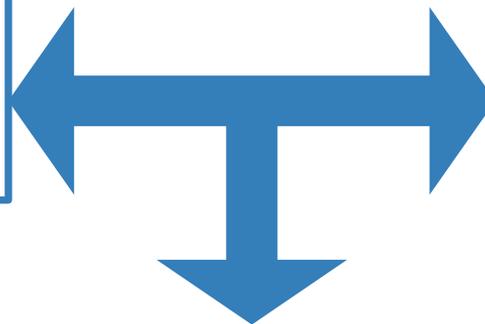
産業用専用計測器  
カスタムバーニン  
IoT-PLCモジュール・アダプター

# 経常利益・当期純利益の推移

2023/3月期は活発な受注による増収影響や高付加価値製品の取組みで増収増益。  
2024/3月期は、3年後の成長のため研究開発費を前期比+205百万円増加計画。



将来の事業展開のための投資、  
財務体質強化のための  
内部留保確保



安定配当の継続実施

## 株主への利益還元も重視したバランス経営を推進

(単位：円)

	1株当たり当期純利益および配当金	
	2023/3月期 実績	2024/3月期 予想
1株当たり当期純利益	107.99	97.19
中間配当金	0	-
期末配当金	15	15
年間配当金	15	15

※2023年5月11日現在において、2024/3月期配当予想額は、1株当たり15円としております。

1. 事業概要・特長
2. 2023年3月期決算の概要
3. 2024年3月期業績予想の概要
4. 成長に向けた取り組み

各事業で『コア事業の集中・安定化』と『新規成長事業』へ取り組み、継続的成長を実現

## ①中核事業の競争力強化

電子システム事業 . . . . . 検査機器の単品販売からソリューションへ展開（スクリーニング、各種専用計測）

マイクロエレクトロニクス事業 . . . アナログを強化し新分野への展開、デジタルをソフトウェアで強化

製品開発事業 . . . . . 医療関連機器・産業機器への事業領域拡大による販売拡大

## ②新技術・新製品の創出早期化、事業化推進

電子システム事業 . . . . . 新機能・デバイス進化に対応したバーンイン装置の開発

マイクロエレクトロニクス事業 . . . JPEGやISPのIP機能進化と自社デバイスの開発

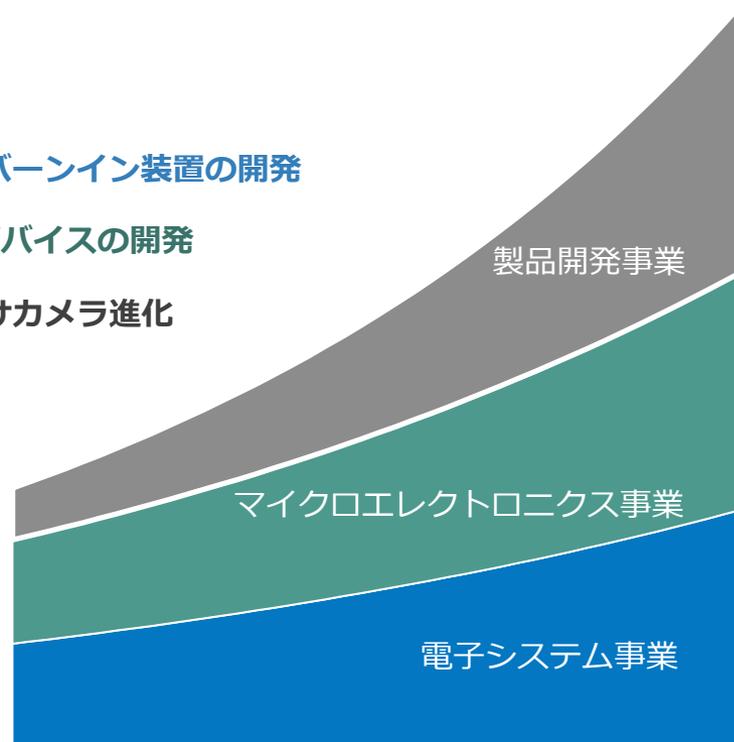
製品開発事業 . . . . . 3D・AI技術導入しセンシング向けカメラ進化

## ③新市場、グローバル戦略の拡大

電子システム事業 . . . . . OSATを足掛かりにした海外展開  
IoT-PLC市場参入

マイクロエレクトロニクス事業 . . . IP販売のグローバル展開

製品開発事業 . . . . . 画像応用製品での事業化推進



売上高	: 66.8億円	(対前年	3.1%)
経常利益	: 5.6億円	(対前年	▲16.2%)
当期純利益	: 4.3億円	(対前年	▲9.9%)

## 経営方針

成長へ向けた事業・ビジネス基盤確立の着実な推進  
- 種まきから刈り取りフェーズへの移行を実現 -

- ✓ 成長ターゲット新分野・新製品での着実な事業立ち上げ
- ✓ 各事業本部 基盤事業の着実な成長
- ✓ 中期を見据えた生産能力強化と効率化・開発拠点強化
- ✓ 新基幹システム稼働とDX化の更なる進展

- 温度制御技術の強みを活かしBI事業のソリューション展開で拡大
- 重点顧客専用計測機の高シェアを維持し、IoT-PLCで新たな売りを作る

## 中核事業の競争力強化

- ◆ BI事業モデルをソリューションに拡張、お客様の多様な要望に応える
- ◆ 重点顧客向け車載機器専用検査装置のバリエーションを拡大

## 新技術・新製品の創出早期化、事業化推進

- ◆ 車のCASE進展に伴うBI装置の技術進化

## 新市場、グローバル戦略の拡大

- ◆ 新領域・グローバルでのビジネスにチャレンジ

### 昨年度の進捗

- 第二工場の取得と稼働に向けた整備の実施・熊本事業所開設
- PLC事業化に向け量産テーマでのデザイン・イン完遂

### 本年度重点事項

- 第二工場本格稼働し、信頼性装置製造・受託試験のキャパシティ拡大
- PLC事業化に向けた量産の開始

- アナログ設計強化とデジタル設計+ソフト技術融合でエンジニアリング事業基盤を強化する
- IP商品の展開と自社ASICで新たな事業を作る

## 中核事業の競争力強化

- ◆ 顧客の水平展開・技術領域拡張しエンジニアリング事業を強化

## 新技術・新製品の創出早期化、事業化推進

- ◆ IPの機能進化と自社デバイスの開発

## 新市場、グローバル戦略の拡大

- ◆ IPのグローバル販売を強化

### 昨年度の進捗

- 重点顧客での事業堅持、パワー関連業務への顧客拡大
- ISP-IPの新規事業化、将来に向けた自社デバイス探索開発の完了

### 本年度重点事項

- 次世代IP（次世代JPEG規格・ISP機能拡張）商品化
- エンジニアリング関東地区開発拠点の強化

- ビューカメラはインフラ・産業で顧客拡大、センシングカメラは性能強化で用途拡大
- 画像応用製品（ビジョンソリューション）で医療・AI応用に参入し新規事業を作る

## 中核事業の競争力強化

- ◆ インフラ機器のDX化を視野にセンシング向け商品ラインナップを強化

## 新技術・新製品の創出早期化、事業化推進

- ◆ AI画像処理に適した新製品開発を加速

## 新市場、グローバル戦略の拡大

- ◆ 画像処理技術を活かした新領域でのビジネスにチャレンジ

### 昨年度の進捗

- 新製品2品種を市場投入し商品ラインナップを強化
- 画像応用製品の要素開発を完了し、事業化開発へ移行

### 本年度重点事項

- 半導体部材EOLに対応した商品開発を実施しお客様への着実な納入
- 3Dカメラ・見守り製品の製品開発と事業化への移行
- 将来の生産能力拡大に備えた本社魚津工場の整備・拡大

社是・社訓に加え新たにMission・Vision・Valueを制定し  
社会への貢献を明確にした事業運営を目指す

## Mission

- 会社理念 -

テクノロジーで新しい価値を創造し、  
安全・安心・効率的な社会の実現に貢献

## Vision

- 会社目標 -

社会が求めるソリューションを  
「計測」×「デバイス」×「カメラ」で提案・実現

## Value

- 行動指針 -

常に「どうあるべきか」を念頭にチャレンジ、  
事実を直視し考え行動する「Fact・Think・Act」の実践

## APPENDIX

バーンイン (ボード)	バーンインは、半導体の初期不良を除去する選別方法の1種。バーンインボードは、通常の使用環境であれば2～3年以内で故障するおそれのある半導体を取り除くテスト工程（パッケージバーンインテスト）で用いられる基板。半導体製品の動作を検証、初期不良品を選別。
LSI	大規模集積回路。ICのうち、素子の集積度が1,000個～10万個程度のものを「MSI」（Medium Scale Integration）、1万ゲート位までのものを「LSI」と呼ぶ。これ以上はVLSI（Very Large Scale Integrated Circuit）と呼ばれている
IC	半導体集積回路。トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ダイオードなどの素子を集めて基板の上に装着し、各種の機能を持たせた電子回路。（Integrated Circuit）
I/F回路 (アイエフ回路)	受信機・通信機において周波数変換された信号を処理する電子回路。
FPGA	プログラムすることができる論理LSI。マイクロプロセッサやASIC（特定用途のために設計されたIC）の設計図を送り込んでシミュレーションすることが可能。（Field Programmable Gate Array）
ASIC	特定の用途のために設計されたIC。フルカスタムICは注文に応じてゼロから設計、セミカスタムICはあらかじめ特定の機能を持った回路ブロックを組み合わせた「半完成品」をもとに、配線を変えることで要求に合わせたもの。（Application Specific Integrated Circuit）
JPEG	静止画像データの圧縮方式の一つ。圧縮の際に若干の画像劣化を許容する（劣化許容レベルの指定が可能）方式と、まったく劣化のない方式を選ぶことが可能、現在のデジタルカメラのほとんどは、記録画像のファイル形式にJPEGを使用。（Joint Photographic Experts Group）
IP	再利用可能な設計資産（知的財産）。ICの設計と製造の分業化により、IPが独自の市場を形成。（Intellectual Property）
MIPI	企業団体MIPI Alliance(本部米国：ノキア、テキサス・インスツルメンツ等により設立)が策定する、モバイル機器のカメラやディスプレイとのインターフェイス規格。（Mobile Industry Processor Interface）
CMOS	半導体の一方式であるMOS（半導体の中で動いている自由電子が、自由電子が飛び出した後の正孔のいずれかによって電荷が運搬されるトランジスタ）を改良したもので、電荷の運搬に自由電子と正孔の両方を用いるため、MOSに比べて動作速度が高い特徴があります。（Complementary Metal Oxide Semiconductor）

## ご清聴ありがとうございました

本資料および決算説明会で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは大きく異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

### ご注意事項

#### 数字の処理について

当社業績に関する記載金額は特に明記が無い限り、以下の通り処理しております。そのため内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- ・表、グラフの金額：表示単位未満を切り捨て
- ・比率：表示単位第1位未満を四捨五入

### お問い合わせ先

株式会社シキノハイテック

常務取締役管理本部長 広田 文男

e-mail：IR-contact@shikino.co.jp

TEL：0765-22-3477 FAX：0765-22-3916

ホームページ：https://www.shikino.co.jp/